

※板狀-粉末冶金法 接點選用參考：

不同額定電流的開關，尺寸、材質的使用，因各種開關機構設計不同與接點材料的進步，很難訂出標準公式，此為多年試驗的經驗數據。

材質	TECC 代號	特性比較(1 良 ~ 9 劣)		
		耐消耗	耐熔著	導電性
AgNi	N30	5	5	3
AgW	W50	3	3	5
	W65	2	2	7
AgW+WC	WK50	3	3	5
AgW	K50	3	3	6-7
	K60	2	2	7
AgWC+C	KC15	7	3	6
	KC23	7	2	7
AgC	C5	8	2	5
CuW	UW60	4	4	7
	UW65	3-4	3-4	7
	UW70	3	3	7-8

註：只限於本表內材質作比較，不與其他材質比較。

※板狀-粉末冶金法 接點設計參考：

1. 常用尺寸公差：

- 1.1 常用粉末冶金的板狀接點之長、寬或外徑，一般最大不宜超過 85mm，最小不低於 3.5mm。
- 1.2 AgNi、AgWC+C、AgC 等材質因使用重壓加工，宜採用 F 型接點。
- 1.3 長度、寬度或直徑公差為 $\pm 0.20\text{mm}$ 。
- 1.4 表面 R 值公差為 $\pm 10R$ 。

1.5 接點厚度(T)公差制定參考：

T 厚(mm)	成型面積(mm ²)	T 厚公差(mm)
1.00 ~ 1.50	25 ~ 150	±0.10
1.51 ~ 2.00	25 ~ 150	±0.15
2.01 ~ 3.00	25 ~ 150	±0.20
1.00 ~ 1.50	151 ~ 200	±0.15
1.51 ~ 2.00	151 ~ 200	±0.20
2.01 ~ 3.00	151 ~ 200	±0.25
1.51 ~ 2.00	201 ~ 320	±0.20
2.01 ~ 3.00	201 ~ 320	±0.30
3.01 ~ 4.00	321 ~ 400	±0.50

※特殊規格者，另行訂定。

2. 銀厚(t)：

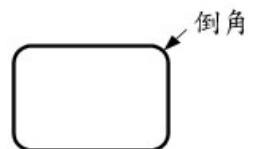
粉末冶金法板狀接點之銀厚(t)最薄至少宜 1.0mm 以上 (依接點面積，面積越大銀厚亦須相對增加)，若銀厚低於 1.0mm 時，建議使用內部氧化法板狀接點。銀厚若超過 3.0mm，則建議使用單壓模具，單壓模具之銀厚(t)最厚為 15mm。

3. 弧面(R)：

弧面有：(A)長邊弧面(B)短邊弧面(C)球面弧面；弧面曲度易因高溫燒結產生變異，故公差較大，一般為±10R。

4. 倒角(r)：

正方形、長方形、梯形等，因粉末冶金加工特性，無 r 角粉末易崩掉，造成接點缺角，為避免缺角，倒角須有 0.5r 以上。



焊片(燒焊或背附)：

- 5.1 除無熔線斷路器(MCCB)因壽命試驗要求次數較少，背附用 BCuP-5 外，其餘開關建議使用 BAg-5、BAg-7 等不含 Cd 的 BAg 材質。
- 5.2 銀焊料的使用量依接點面積大小不同，背附焊片覆蓋面積須大於接點面積 50%以上。粉冶背面花紋深淺不一，其焊片厚度應隨之調整。
- 5.3 焊好的接點與銅座至少有 70%黏著，沿接點四周可看見熔融之焊片溢出 (高度低於接點厚度的一半)，且緊接接點四周圍繞為原則。

